

MES 2012 プログラム		9月13日 (木)	
	A会場	B会場	C会場
9:10	【2A1】 回路基板・プロセス 1. Cuダイレクトレーザー穴あけ対応 前・後処理プロセスの開発 ○安藤裕久 (荏原ユーージャイト) 2. 硫酸-過酸化水素溶液による銅のエッチングレートに結晶構造が及ぼす影響 ○久保田賢治 ^{1,2} , 松本克才 ³ , 吉原佐知雄 ¹ (1 宇都宮大学大学院, 2 三菱マテリアル, 3 八戸工業高等専門学校) 3. 転写ミラー工法による光電フレキシブル配線板の作製 ○中芝 徹, 八代調子, 近藤直幸, 橋本真治 (パナソニック) 4. ポリイミドフィルム上への直接メタライジング法による両面フレキシブルプリント配線板の開発 ○宮脇 学 ¹ , 道脇 茂 ¹ , 工藤孝廣 ² , 松野祐亮 ² , 森邦夫 ² (1 メイコー, 2 いおう化学研究所) 5. ポリイミドフィルム上に直接めっきをした両面フレキシブルプリント配線板の特性評価 ○八甫谷明彦 ¹ , 宮脇 学 ² , 道脇 茂 ² , 瀧井秀吉 ² (1 東芝, 2 メイコー)	【2B1】 マイクロ加工 1. 光インタコネクション用低コスト光コネクタの開発 ○青木 剛 ¹ , 村中秀史 ¹ , 青木重憲 ¹ , 末松克輝 ² , 岩屋光洋 ² , 椎野雅人 ² (1 富士通研究所, 2 古河電気工業) 2. 集束プロトンビームを用いたPMMA光ファイバーの微細加工 ○加藤 聖 ¹ , 西川宏之 ^{2,3} , 林 秀臣 ³ (1 芝浦工業大学大学院, 2 芝浦工業大学, 3 芝浦工業大学先端工学研究機構) 3. 干渉色による高速膜厚分布測定装置の開発 北川克一, 〇大槻真左文, 坪井辰彦 (東レエンジニアリング) 4. PB-LIGAを用いた局所インプリントプロセスとその応用展開 ○高橋潤一 ¹ , 岩本隆志 ¹ , 田邊裕介 ¹ , 西川宏之 ^{2,3} , 林秀臣 ³ , 石井保行 ⁴ , 神谷富裕 ⁴ , 佐藤隆博 ⁴ (1 芝浦工業大学大学院, 2 芝浦工業大学, 3 芝浦工業大学先端工学研究機構, 4 原子力機構高崎) 5. 微少液滴塗布システムを用いた微細配線欠陥のリペア ○加藤好志 ¹ , 高橋貞行 ¹ , 入江優花 ¹ , 青山尚之 ² (1 アプライド・マイクロシステム, 2 電気通信大学)	【2C1】 評価・シミュレーション 1. デバイス内部の応力集中と真性キャリア濃度変化を考慮したnMOSEFETの電気特性変動デバイスシミュレーション ○多田直弘 ¹ , 小金丸正明 ² , 池田 徹 ¹ , 宮崎則幸 ¹ , 友景 肇 ³ (1 京都大学大学院, 2 福岡県産業・科学技術振興財団, 3 福岡大学) 2. 有限要素法を用いた結晶シリコン太陽電池の劣化予測 ○山口修平, 澁谷忠弘 (横浜国立大学) 3. MEMS薄膜の湿度による割れに関する考察 中尾太一, 松井悦子, 新谷淳一, 〇河野好映 (オムロン) 4. リチウムイオン二次電池の安全性と評価試験 ○青木雄一, 河合秀吉, 奥山 新 (エスベック) 5. リザーバ構造配線におけるエレクトロマイグレーション損傷の数値シミュレーションによるしきい電流密度の評価 笹川和彦, 〇柳 貴裕, 鶴沼 潤 (弘前大学大学院)
10:50			
11:00	【2A2】 パワエレ-3 高放熱材 1. ハイブリッド材料の熱伝導メカニズムと材料設計 ○井上雅博 (群馬大学) (依頼講演 40分) 2. ワイドバンドギャップ半導体用封止樹脂材料の開発～高熱伝導化と高耐熱化の検討～ 石川有紀, 〇高尾知哉, 上野健一, 土肥一博, 萩島賢児 (サンキュレック) 3. 低融点型液晶性エポキシ樹脂の熱伝導性 ○原田美由紀, 池尾康宏, 服部聖也, 越智光一 (関西大学)	【2B2】 めっき-1 1. チップ部品の電極部への選択的無電解めっき析出の検討 ○小岩一郎 ^{1,2,3} , 中田龍之介 ² , 金田雄希 ¹ , 福井健太 ¹ , 渡辺宜朗 ² , 橋本 晃 ³ (1 関東学院大学, 2 関東学院大学大学院, 3 関東学院大学工学総合研究所) 2. 2層タイプ薄膜銅/ポリイミド基材へのダイレクトめっき工法の適用 西川忠寛 ¹ , 〇村主欣久 ² (1 東レフィルム加工, 2 アトテックジャパン) 3. 鉛フリー無電解Niめっき皮膜中の共析物とはんだ実装信頼性 ○土田徹勇起 ¹ , 大久保利一 ¹ , 狩野貴宏 ² , 荳司郁夫 ² (1 凸版印刷, 2 群馬大学大学院) 4. イオン液体を用いたCr及びAl電析 ○渡辺宜朗, 久我裕紀, 小岩一郎 (関東学院大学)	【2C2】 先端検査システム 1. プリント配線近傍に生じる静電容量を用いた欠陥検出システムに関する研究 ○野口祐智, 斎藤之男, 角田興俊, 富田英雄 (東京電機大学) 2. TDR法によるTSV接続不良の評価 ○大塚裕明, 韓 榮建, 崔 雲, 堀内 整, 友景 肇 (福岡大学) 3. 連続電気化学還元法によるはんだパンプ表面酸化膜測定とパンプ融合試験による実装性への影響評価 ○石川信二, 橋野英児, 小林孝之, 田中将元 (新日本製鐵) 4. 放射光X線ラミノグラフィによるフリップチップはんだ接合部の熱疲労き裂進展評価 ○釣谷浩之 ¹ , 佐山利彦 ¹ , 岡本佳之 ² , 高柳 毅 ² , 上杉健太郎 ³ , 星野真人 ³ , 森 孝男 ⁴ (1 富山県工業技術センター, 2 コーセル, 3 高輝度光科学研究センター, 4 富山県立大学)
12:20			
13:20	【2A3】 パワエレ-4 耐熱接合技術 1. パワーデバイスパッケージの実装技術 ○宝蔵寺裕之 (日立製作所) (依頼講演 40分) 2. 低温焼結性Cuナノ粒子の開発 ○石崎敏孝, 渡邊亮太, 明渡邦夫, 佐藤敏一 (豊田中央研究所) 3. 高温はんだ代替Cuナノ粒子ペーストの接合性に及ぼす接合条件の影響 ○西川 宏 ¹ , 平野智章 ¹ , 竹本 正 ¹ , 寺田信人 ² (1 大阪大学, 2 ハリマ化成) 4. 酸化銅粒子を用いた高温環境向け接合材料の開発と接合機構の解明 ○保田雄亮 ¹ , 守田俊章 ¹ , 前田貴史 ² , 小林芳男 ² (1 日立製作所, 2 茨城大学)	【2B3】 めっき-2 1. 急速液置換による銅めっき用有機系添加剤の吸脱着挙動解析 ○辻本悠一, 宮本 豊, 齊藤丈靖, 岡本尚樹, 近藤和夫 (大阪府立大学) 2. 三種混合基板及びガラスへの無電解Ni-Pめっき薄膜の密着力検討 ○中田龍之介 ¹ , 押切絢貴 ¹ , 梅本博史 ¹ , 橋本 晃 ² , 小岩一郎 ¹ (1 関東学院大学, 2 関東学院大学工学総合研究所) 3. 電解銅めっきにおけるPRパルス電流制御による直径4μmピア完全充填 ○林 太郎 ¹ , 竹内 実 ^{1,3} , 岡本尚樹 ¹ , 齊藤丈靖 ¹ , 近藤和夫 ¹ , 横井昌幸 ¹ , 丸中正雄 ² , 土屋貴之 ² , 文屋勝 ³ (1 大阪府立大学大学院, 2 新明和工業, 3 日東紡績) 4. 電気Niめっきを用いた構造物の作製 ○岡田孝史, 岡本尚樹, 齊藤丈靖, 近藤和夫 (大阪府立大学大学院) 5. めっき法を用いた偏光子の作製 ○岡本尚樹 ¹ , 池田裕一 ¹ , 小山義則 ¹ , 齊藤丈靖 ¹ , 近藤和夫 ¹ , 河津泰幸 ² (1 大阪府立大学大学院, 2 旭化成イーマテリアルズ)	【2C3】 高周波・EMC 1. 基板材料のミリ波帯誘電特性評価 ○近藤裕介, 水嶋悦男, 水野康之 (日立化成工業) 2. ツイストペア線のディファレンシャルモード伝送特性の検討 ○高橋丈博 ¹ , Li Niu ² , Todd Hubing ² (1 拓殖大学, 2 クレムソン大学) 3. プリント基板のESDシミュレーション ○金子俊之 ¹ , 石田尚志 ² , 森下 健 ² , 矢口貴宏 ³ (1 トッパンNECサークイットソリューションズ, 2 日本電気, 3 NEC情報システムズ) 4. プリント基板の平板間共振を抑制する抵抗値の検討 ○高橋丈博 ¹ , 齋藤 純 ² , 谷 由紀夫 ¹ , 澁谷 昇 ¹ (1 拓殖大学, 2 拓殖大学大学院) 5. プリント基板上に形成したワイヤレス電力伝送用スパイラルコイルの結合係数の向上の検討 ○今野宗一郎, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学)
15:00			
15:10		【2B4】 接合評価 1. 低Ag系Sn-Ag-Cu-Znはんだの熱衝撃試験特性 ○濱田真行 ¹ , 上杉徳照 ² , 瀧川順康 ² , 東 健司 ² (1 石川金属, 2 大阪府立大学大学院) 2. SEMとデジタル画像相関法によるひずみ計測を利用した三次元積層チップの非線形有限要素法解析の精度向上 ○岡 大智 ¹ , 河原真哉 ¹ , 池田 徹 ¹ , 宮崎則幸 ¹ , 松本圭司 ² , 小原さゆり ² , 折井靖光 ² , 山田文明 ² , 嘉田守弘 ³ (1 京都大学大学院, 2 日本アイ・ビー・エム, 3 超先端電子技術開発機構) 3. SbおよびZn添加Sn-Bi共晶はんだ接合部の繰返し落下寿命特性 ○岡本圭史郎 ¹ , 赤松俊也 ¹ , 作山誠樹 ¹ , 上西啓介 ² (1 富士通研究所, 2 大阪大学大学院) 4. Sn-Bi共晶はんだを用いた微細はんだ接合部のエレクトロマイグレーション挙動に及ぼすバリア層の影響 ○酒井 徹 ¹ , 八坂健一 ¹ , 赤松俊也 ² , 今泉延弘 ² , 岡本圭史郎 ² , 作山誠樹 ² , 上西啓介 ¹ (1 大阪大学大学院, 2 富士通研究所)	【2C4】 アンテナ・人体通信 1. 電子機器筐体への搭載を考慮したスリット付加広帯域アンテナの検討 ○櫻井 佑, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学) 2. 折り曲げた半円台形非平衡ダイポールアンテナの電子機器への実装の基礎検討 ○秋山佑祐 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (1 国士舘大学, 2 東京理科大学) 3. 電磁界共振結合を利用した人体周辺通信の検討 ○越地福朗 ¹ , 湯山菜奈子 ¹ , 越地耕二 ² (1 国士舘大学, 2 東京理科大学) 4. 電磁界共振結合を利用した人体周辺通信における伝送特性の検討 ○湯山菜奈子 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (1 国士舘大学, 2 東京理科大学) 5. 人体通信用新型電界センサによる微小信号測定 ○加藤康男, 水澤純一, 佐久田博司 (青山学院大学大学院)
16:50			